

## 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用与结余情况

##### 1.2021 年至 2023 年募集资金使用与结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 355,009,865.99 元，对三个募集资金项目累计投入人民币 234,221,046.82 元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 544,637,275.50 元（其中

含银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额 16,767,025.94 元)。

## 2.2024 年半年度募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金人民币 445,853,170.07 元,对三个募集资金项目累计投入人民币 324,264,350.90 元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额人民币 454,296,388.23 元。

明细	金额(单位:人民币元)
<b>2021 年 12 月 16 日募集资金到账余额</b>	882,999,989.85
减:募投项目投入	324,264,350.90
其中:募集资金投资项目先期投入置换(2022 年)	10,874,810.80
募集资金投资项目使用(2022 年)	2,598,375.85
募集资金投资项目使用(2023 年)	220,747,860.17
募集资金投资项目使用(2024 年 1-6 月)	90,043,304.08
上市公司募集资金补充流动资金(2021-2023 年)	120,788,819.17
上市公司募集资金补充流动资金(2024 年 1-6 月)	800,000.00
应收保证金	119,874.30
加:银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额(2021-2023 年)	16,767,025.94
银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额(2024 年 1-6 月)	502,416.81
<b>2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>454,296,388.23</b>

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》经公司 2021 年 5 月 31 日第十二届第二次董事会和 2021 年第三次临时股东大会审议通过;2022 年 8 月 2 日第十二届第十一次董事会对该《管理办法》进行了第一次修订,并经 2022 年第二次临时股东大会审议通过;2023 年 10 月 26 日第十二届第

十七次董事会对该《管理办法》进行了第二次修订，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中电科芯片技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	882,999,989.85	185,394,808.76	活期
重庆西南集成电路设计有限责任公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	-	196,165,300.27	活期
重庆中科芯亿达电子有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	-	21,612,732.16	活期
深圳市瑞晶实业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	-	51,123,547.04	活期
<b>合计</b>	-	-	<b>882,999,989.85</b>	<b>454,296,388.23</b>	-

## 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表（2024年半年度）”。

### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

2023年1月13日，子公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户（详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》）。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币63,000.00万元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	23,645.84 (未收回 534.89)	106.66
	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	80.02 (未收回 978.88)	75.52
	单位协定存款	131.97	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	30.00 (未收回 101.97)	-
	单位协定存款	30,232.50	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	26,945.37 (未收回 3,287.13)	-
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	2,583.66 (未收回 2,142.23)	35.09
	单位协定存款	-	固定收益	2022.1.29 2023.1.16	1.90	1860.19 (未收回 0)	20.67
	公司稳利 22JG6132 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.1.29 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利 22JG6862 期结构性存款产品	24,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利 22JG3528 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5 2022.8.5	3.10	30,000.00	232.50
	公司稳利 22JG3596 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.6.10 2022.7.11	2.85	23,000.00	56.45
	公司稳利 22JG7309 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.7.12 2022.8.12	2.85	23,000.00	54.63
	公司稳利 22JG7517 期结构性存款产品	50,000.00	保本浮动 收益型	2022.8.15 2022.11.15	3.05	50,000.00	381.25
	公司稳利 22JG8099 期结构性存款产品	53,000.00	保本浮动 收益型	2022.11.16 2023.1.16	2.90	53,000.00	256.17
<b>合 计</b>		295,835.48				288,140.08	1,525.34

2023年1月16日，公司将用于现金管理的闲置募集资金本金及收益共计人民币

55,137.03万元全部归还至公司募集资金专户（详见公司于2023年1月18日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并归还的公告》）。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司本次发行不存在超募资金。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司本次发行不存在超募资金。

**（七）节余募集资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目变更情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》（详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），同意将智能电源集成电路应用产业园建设项目实施地点及投资金额进行调整，具体变更情况如下：

募投项目	变更事项	调整前	调整后
智能电源集成电路应用产业园建设项目	实施地点	广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园（生产基地） 深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）	广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园
	投资总额	32,792.11	32,434.00
	自有资金投资额	955.11	597.00
	预计募集资金投资金额		31,837.00

由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，并经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》（详见公司于2023年12月15日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》），同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2025年12月，该项目募集资金的使用情况如下：

项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	募集资金实际投入进度（%）	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后可使用状态日期
智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00万元	20,916.74万元	65.70	2023年12月	2025年12月

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024年8月10日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

### 2024 年半年度

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		90,000.00					本年度投入募集资金总额		9,084.33				
变更用途的募集资金总额		不适用					已累计投入募集资金总额		44,585.32				
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	不适用	33,656.38	33,656.38	33,656.38	4,283.33	8,589.39	-25,066.99	25.52	2026 年 12 月	建设中	-	否	
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	不适用	12,084.79	12,084.79	12,084.79	945.88	2,920.31	-9,164.48	24.17	2024 年 12 月	建设中	-	否	
智能电源集成电路应用产业园建设项目	不适用	31,837.00	31,837.00	31,837.00	3,775.12	20,916.74	-10,920.26	65.70	2025 年 12 月	建设中	-	否	
补充流动资金	不适用	12,421.83	10,721.83 (注 1)	10,721.83	80.00	12,158.88	1,437.05 (注 2)	113.40	-	-	-	-	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>90,000.00</b>	<b>88,300.00</b>	<b>88,300.00</b>	<b>9,084.33</b>	<b>44,585.32</b>	<b>-43,714.68</b>	<b>50.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		智能电源集成电路应用产业园建设项目因实施地点变更、投资金额调整等因素影响, 导致项目实施进度晚于预期, 详见《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》(公告编号: 2023-017)、《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-038)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		置换高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目先期投入 1,087.48 万元, 详见三 (二)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金, 于 2023 年 1 月 13 日全部归还, 详见三 (三)。											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况		公司使用不超过人民币 63,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品 (结构性存款), 于 2023 年 1 月 16 日归还, 详见三 (四)。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余金额 45,429.64 万元。											
募集资金其他使用情况		不适用											

注1: 补充流动资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额1,700万元系承销费用金额。

注2: 补充流动资金累计投入金额与承诺投入金额的差额1,437.05万元, 系用于补流的银行存款利息及投资理财收益。

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能电源集成电路应用产业园建设项目	智能电源集成电路应用产业园建设项目	31,837.00	31,837.00	3,775.12	20,916.74	65.70	2025 年 12 月	建设中	-	否
<b>合计</b>	-	<b>31,837.00</b>	<b>31,837.00</b>	<b>3,775.12</b>	<b>20,916.74</b>	-	-	-	-	-
<b>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</b>				<p>由于“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。公司充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的议案》，同意将项目实施地点调整为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园，投资总额调整为 32,434.00 万元（详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》）；公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议审议通过《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月（详见公司于 2023 年 12 月 15 日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》）。</p>						
<b>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</b>				实施地点变更和投资金额调整导致项目实施进度晚于预期。						
<b>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</b>				不适用						